



® 平成 30 年 8 月 6 日 (月)

No. 14745 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許無効審決(不成立)取消請求事件

(「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」(特許第4447798号)発明の容易想到性誤認事件) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10063号、平成30年2月20日判決言渡—

本件発明1は、本件発明の効果は格別の効果を奏しえたことを根拠に、当業者が容易に考え付いたことではないと判断した特許無効審判の審決取消訴訟で、本件発明の解決手段並びに効果及びその確認手段等が検討され、本件発明の効果は確認手段が十分に示されていないなどとして甲1発明及び技術常識から見て当業者が予測し得ないほどの格別顕著なものではないと裁判所は判断し、審決が取り消された事例である。

第1 裁判所の判断

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。

 **TH弁護士法人**

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

1 本件各発明

本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は、下記（第3の2）のとおりである。

2 本件各発明の概要

- (1) 本件各発明は、特に、鉛及び亜鉛を含まないはんだ合金粉末を用いた場合に好適なソルダペースト組成物及びこれを用いたリフローはんだ付け方法に関する（【0001】）。従来、電子部品の表面実装におけるリフローはんだ付けに用いるソルダペーストは、S n - P b系のはんだ粉末を含むものが大部分を占めていたが、環境や人体への影響に対する問題から、鉛を含まないはんだ材料が開発され、S n - A g 合金、S n - A g - C u 合金等のいわゆる無鉛系のはんだ合金粉末が用いられるようになってきた（【0002】）。
- (2) 上記の無鉛系のはんだ合金粉末は、融点が約200～220℃と高いので、そのはんだ粉末を含有するソルダペーストを用いたリフローはんだ付け方法では加熱時のピーク温度を230～240℃にする必要があり、熱に弱い電子部品の熱損傷による機能劣化等を起こさせるという問題点がある。この問題点を改善するために、プリヒート時に、従来より高い温度で加熱する、いわゆるヒートパターンを変更することにより、電子部品の熱損傷を緩和する試みが行われているが、この方法ではプリヒート時の加熱の熱量が増えるため、はんだ合金粉末及びフラックスが過度に熱せられることになって酸化による熱劣化を起こしやすく、リフロー時にフラックス膜やはんだ粉末に不溶物が生じ、はんだ付け強度を低下させる等のはんだ付け性の特性を低下させてしまうという別の新たな問題を引き起こす（【0003】）。
- (3) 本件各発明は、上記の問題に対し、無鉛系はんだ粉末にヒンダードフェノール系化合物を併用したソルダペーストを用いることにより、無鉛系はんだ粉末とソルダペースト膜のリフロー時の劣化を防止するというものである（【0005】）。

本件各発明においては、分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を併用することにより、高温のリフロー時においても無鉛系はんだ粉末及びフラックス膜の熱劣化を防止することができ、はんだ付け性の特性が低下せず、リフロー時のヒートパターンの変更により高温に弱い電子部品の熱損傷を避けることができ、これにより回路の信頼性の高い実装基板を得ることができるソルダペースト組成物及びリフローはんだ付け方法を提供することができる（【0018】）。

3 取消事由1について

(1) 甲1発明

甲1発明は、低残渣タイプのはんだ付け用フラックス及びクリームはんだに、分子内に第3ブチル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を配合し、低固形分であってもフロー及びリフロー中の基板や部品及びはんだ再酸化を防止することを可能としたはんだ付け用フラックス及びクリームはんだを供給するものである。

(2) 検討

ア 甲1文献を主引例とする進歩性の判断につき、本件審決は、甲1発明において、本件発明1と甲1発明との相違点1に係る本件発明1の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得ることであるが、本件発明1は当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものであることから、本件発明1は甲1発明に基づき当業者が容易に発明することができたものではない旨判断する。そこで、この点について検討する。

イ 本件明細書の記載について

- (ア) 本件発明1は、高温のリフロー時においても無鉛系はんだ粉末及びフラックス膜の酸化による熱劣化を防止することをその課題の1つとする。